

## 酸铜光剂

### CHIBA-10

#### 药浴组成及作业条件

名称	范围	建议	消耗量
硫酸铜	150~230g/L	200g/L	
硫酸	50~90g/L	70g/L	
氯离子	60~150mg/L	70mg/L	
M	4~8ml/L	5ml/L	10~20ml/KAH
A	0.4~0.7ml/L	0.5ml/L	50~60ml/KAH
B	0.1~0.3ml/L	0.1ml/L	40~60ml/KAH
电流	1~5A/dm <sup>2</sup>		
浴温	25°C (20-40°C)		
搅拌	强烈、均匀的空气搅拌		
阳极	磷铜 (必须使用钛盐和阳极袋)		

#### 特性

高光泽镜面感，饱满度强以及低区延展性佳，氯离子的操作范围广、耐温性强，不易针孔或起砂。

#### 应用范围

大五金件、锌压铸件、塑胶件、展示架等。

#### 铜和硫酸

当铜或硫酸的浓度太低时高电位容易产生树枝状和烧焦。

#### 氯离子

太低时会造成整平不佳甚至产生麻点。氯离子补可使用氯化钠 (氯离子 1mg/L=1.7mg/L) 或盐酸 (分析纯 37%) 即氯离子 1mg/L=0.0023ml/L。

#### 光剂

M 太少—>整体光泽整平不足，太多会出现白雾。

A 太少—>整体光泽会变弱，太多高区容易有树枝状。

B 太少—>高区光泽不良，过多低区光泽不良。

#### 温度

最适合的温度为 25°C，温度越高光剂消耗量会增加。

#### 搅拌

搅拌不充分容易产生烧焦。

#### 过滤

连续过滤，使用活性炭会除去相当程度的光剂。

#### 电流

必须以镀件的形状及作业条件等因素来决定；密度不同则镀层特性及光剂的消耗量会改变；密度低时镀层饱满度变差、内应力减少、硬度稍微提高。

#### 管理方法

成分：平时分析硫酸铜和硫酸的成分，氯离子会随电解减少。

光剂：消耗量会因电流密度、温度、释出等因素不同而影响。

活性炭处理后须再重建新浴或补充适量的光剂。

#### 包装规格

25kg/灰桶

此说明书的所有内容与建议是以本公司的实验数据为基准，由于各使用者在操作及设备上有差异，因此对于相关产品使用结果不作任何保证亦不负不良结果所导致的损害责任。

此说明书内所有资料，亦不得作为侵犯版权之证据。

